

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

591

ML10

Erstellt:

Landwehr, Melanie

Kunde:

Datum:

17.12.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	165		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
		35	L2	
A-RS-FR4-ML-0.20mm-035+035-TG150-HF	50200653	200		4
		35	L3	
				A01
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	110		5
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		6
		35	L4	
A-RS-FR4-ML-0.20mm-035+035-TG150-HF	50200653	200		7
		35	L5	
				A02
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		8
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9
		35	L6	
A-RS-FR4-ML-0.20mm-035+035-TG150-HF	50200653	200		10
		35	L7	
				A03
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	110		11
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		12
		35	L8	
A-RS-FR4-ML-0.20mm-035+035-TG150-HF	50200653	200		13
		35	L9	
				A04
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	165		14
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		15
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	16

B00

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2090 µm

Dmin:

1690 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1861 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik